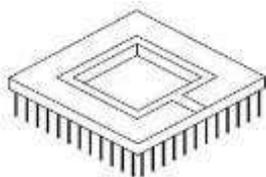


ELECTRONICS MECHANIC 2nd Year
Chapter Name- BASIC SMD

1- 1 What is the type of SMD IC package? 1 एसएमडी आईसी पैकेज के प्रकार क्या है?



- A : PGA pack पीजीए पैक
- B : TSOP pack टीएसओपी पैक
- C : Flat pack फ्लैट पैक
- D : Quad flat pack क्वाड फ्लैट पैक

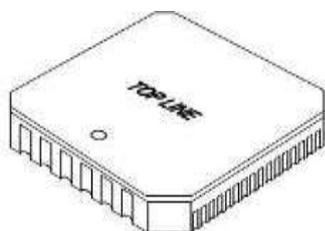
Answer-A

2 : What is the acceptable resistance value limit for the ESD wrist strap? ESD रिस्ट स्ट्रैप के लिए स्वीकार्य प्रतिरोध मूल्य सीमा क्या है?

- A : 12
- B : 1kQ
- C : 1MQ
- D : 10MQ

Answer-C

3: What is the type of SMD IC package? एसएमडी आईसी पैकेज के प्रकार क्या है?



- A : LCC
- B : PLCC
- C : MLCC
- D : TSOP

Answer-A

4 : What is the power rating of soldering iron used in electrical and electronics work? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स काम में उपयोग किए जाने वाले टांका लगाने वाले सोल्डरिंग आयरन की शक्ति रेटिंग क्या है?

- A: 15 to 35 watts
- B: 40 to 65 watts
- C: 75 to 100 watts
- D : 85 to 135 watts

Answer-A

5 : What is the full form of the abbreviation PGA used in SMD IC package? SMD IC पैकेज में उपयोग किए जाने वाले PGA का पूरा रूप क्या है?

- A : Package Grid Array पैकेज गिड ऐरे
- B : Pin Grid Array पिन गिड ऐरे
- C : Perfect Grid Array बिल्कुल सही गिड ऐरे

D : Popular Grid Array लोकप्रिय ग्रिड ऐरे

Answer-B

6- Which type of hot air pencil tip is used in SMD soldering? एसएमडी सोल्डरिंग में किस प्रकार की गर्म हवा पेंसिल टिप का उपयोग किया जाता है?



A : Oval type ओवल टाइप

B: Round type राउंड टाइप

C : Angled type एंगल्ड टाइप

D : Fine jet type फाइन जेट टाइप

Answer-C

7- What is the range of temperature setting on soldering work station for soldering SMD ICs? सोल्डरिंग एसएमडी आईसी के लिए सोल्डरिंग वर्क स्टेशन पर तापमान सेटिंग की सीमा क्या है ?

A: 100°C to 200°C

B: 200°C to 250°C

C : 250°C to 280°C

D: 280°C to 400°C

Answer-C

8 : How does the desoldering braid removes the molten solder from the joint on the PCB? डीसोल्डरिंग ब्रेड पीसीबी पर जोड़ से पिघला हुआ फ्लक्स कैसे निकालता है?

A : By capillary action केशिका क्रिया द्वारा

B : By heating the joint जोड़ को गर्म करके

C : By hardening the solder सोल्डर को सख्त करके

D : By increasing the temperature तापमान में वृद्धि करके

Answer-A

9 : Which method is effective to control ESD, during manufacturing the devices? उपकरणों के निर्माण के दौरान ईएसडी को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि प्रभावी है?

A : Use helmet हेलमेट का उपयोग करें

B : Use metal chain धातु चेन का उपयोग करें

C : Use ESD wrist strap ESD कलाई का पट्टा का उपयोग करें

D : Use tables टेबल्स का उपयोग करें

Answer-C

10- Which technology is used to place the components directly on the printed circuit boards? मुद्रित सर्किट बोर्डों पर घटकों को सीधे रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है?

A : Solder Mount Technology सोल्डर माउंट प्रौद्योगिकी

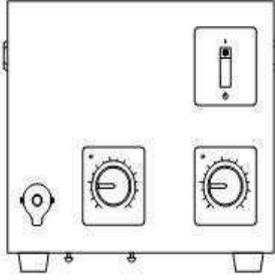
B : Surface Mount Technology भूतल माउंट प्रौद्योगिकी

C : Safety Metaphor Technology सुरक्षा रूपक प्रौद्योगिकी

D : Silicon multiplayer Technology सिलिकॉन मल्टीप्लेयर प्रौद्योगिकी

Answer-B

11 : What is the name of the device? उपकरण का नाम क्या है?



A : Microcontroller माइक्रो कंट्रोलर

B : Signal generator संकेत उत्पादक यन्त्र

C : SMD workstation एसएमडी कार्य केंद्र

D : Insulation tester इन्सुलेशन परीक्षक

Answer-C

12- What is the name of SMD tool? उपकरण का नाम क्या है?

A: 90° forming tool

B Monocole magnifier

C: Heated tweezers

D: Soldering pumps

Answer-C



13- Which type of leads constructed in SOIC package? SOIC पैकेज में किस प्रकार के लीड का निर्माण किया गया है?

A Pad sin leads पेड सीन लीड्स

B : Gull wing leads गूल विंग लीड्स

C: Flat leads फ्लैट लीड्स

D: Pitch ball leads पिच बॉल लीड्स

Answer-B

14 : Which SMD IC needs lead forming equipment to cut and bent into gull wing type? YASMD IC को गूल विंग प्रकार में कटौती और झुकाने के लिए सीसा बनाने वाले उपकरण की आवश्यकता होती है?

A : TSOP

B : FLAT Package फ्लैट पैकेज

C : Pin grid array पिन गिड एरे

D : Leaded chip carrier लीडेड चिप कर्रिएर

Answer-B

15- Which is alternative to ceramic SMD IC packages? सिरेमिक SMD IC पैकेज का विकल्प क्या है?

A : Glass packages ग्लास पैकेज

B: Plastic packages प्लास्टिक के पैकेज

C : Metal packages धातु पैकेज

D : Fiber packages फाइबर पैकेज

Answer-B

16 : What is the purpose of bumpered corners of the Bumpered Quad Flat Pack? बम्पर क्वाड फ्लैट पैक के बम्पर कोनों का उद्देश्य क्या है?

A : Prevent Vibration कंपन को रोकें

B: Dissipate heat उष्मा नष्ट करना

C Protects the IC leads आईसी लीड की रक्षा करता है

D : Gives mechanical strength यांत्रिक शक्ति देता है

Answer-C

17 : What is the full form of the abbreviation SOIC ? संक्षिप्त नाम SOIC का पूर्ण रूप क्या है?

A : Surface Optimized Internal Circuits भूतल अनुकूलित आंतरिक सर्किट

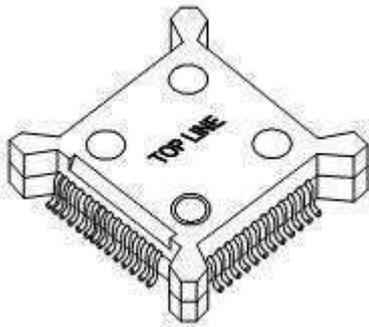
B : Small Outline Integrated Circuits छोटी रूपरेखा एकीकृत परिपथ

C : Service Outline Internal Circuits सर्विस रूपरेखा आंतरिक सर्किट

D : Solder Oriented Integrated Circuits सोल्डर ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट

Answer-B

18 : What is the name of the IC package? IC पैकेज का नाम क्या है?



A : CQFP

B : PQFP

C : BQFP

D : LQFP

Answer-C

19 : What is the full form of the abbreviation SMT? संक्षिप्त नाम SMT का पूर्ण रूप क्या है?

A : Specific Multipin Technology विशिष्ट मल्टीपिन प्रौद्योगिकी

B : Small Metalized Technology लघु धातु प्रौद्योगिकी भूतल

C : Surface Mount Technology भूतल पर्वत प्रौद्योगिकी

D: Solder Mount Technology मिलाप माउंट प्रौद्योगिकी

Answer-C

20 : What is the use of Bench top Ionisers ? बेंच शीर्ष Ionisers का उपयोग क्या है?

A: To control moisture in atmosphere वातावरण नियंत्रित करने के लिए

B : To control ESD in work environment काम के माहौल में ESD को नियंत्रित करने के लिए

C : To control voltage वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए

D : To eliminate molecules अणुओं को कम करने के लिए

Answer-B

21 : What is called 'tinning' in soldering ? सोल्डरिंग प्रक्रिया में टिनिंग किसे कहते हैं?

A : Clean the tip of the iron लोहे की नोक को साफ करें

B : Change the tip of the iron लोहे की नोक को बदलें

C : Melt a little solder on the tip of the iron लोहे की नोक पर थोड़ा फ्लक्स पिघलाएं

D : Remove the tip of the iron लोहे की नोक को हटा दें

Answer-C

22 : What is the name of the defect caused due to ESD event? ESD घटना के कारण उत्पन्न दोष का नाम क्या है?

- A : Mechanical defect यांत्रिक दोष
- B : Dripping defect ढकेलने का दोष
- C : Latent defect अप्रकट दोष
- D : Tombstone defect टोम्बस्टन दोष

Answer-C

23 : How to minimize the cause of ESD during the manufacturing of devices? उपकरणों के निर्माण के दौरान ईएसी के कारण को कैसे कम करें ?

- A : Used for heel groundings एडी ग्राउंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है
- B : Used ESD controlled footwear ESD नियंत्रित फुटवियर का इस्तेमाल किया
- C : Used normal footmat सामान्य फुटमैट का
- D : Wear plastic dress material प्लास्टिक की पोशाक सामग्री पहनें इस्तेमाल किया

Answer-B

24 : What is the percentage of defect caused to devices due to ESD? | ESD के कारण उपकरणों को होने वाले दोष का प्रतिशत क्या है?

- A : 10 to 20
- B : 25 to 30
- C : 35 to 50
- D : 60 to 90

Answer-D

25 : Which material is used to make conductive shoe covers to protect from static charges? | स्थिर आवेशों से बचाने के लिए प्रवाहकीय जूता कवर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?

- A: Fiber रेशा
- B : Copper तांबा
- C: Plastic प्लास्टिक
- D : Polypropylene पॉलीप्रोपलीन

Answer-D

26 : What is the cause of 'Voiding' in SMT? एसएमटी में Voiding का कारण क्या है?

- A : Damaged wiring क्षतिग्रस्त वायरिंग
- B : Damaged component क्षतिग्रस्त घटक
- C : Damaged joint strength क्षतिग्रस्त जॉइंट स्ट्रेंथ
- D : Restricted voltage level प्रतिबंधित वोल्टेज स्तर

Answer-C

Credit- NIMI Bharat Skills

- अच्छी तैयारी के लिए आज ही Global iTi मोबाइल एप्प डाउनलोड कीजिये
- Global iTi Mobile App Download Link- <https://play.google.com/store/apps/details?id=co.davos.srgz>
- Free Pdf + Online Test Global iTi Website Link – <https://globaliti.org/>
- Global iTi YouTube Channel Link- <https://www.youtube.com/globaliti>